



Research and
Development Center

AI 硬件需求景气，关注 PCB 专用设备
机械设备

2025 年 9 月 8 日

证券研究报告

行业研究

行业事项点评

机械设备

投资评级 看好

上次评级 看好

王锐 机械行业首席分析师

执业编号：S1500523080006

邮箱：wangrui1@cindasc.com

韩冰 机械行业分析师

执业编号：S1500523100001

邮箱：hanbing1@cindasc.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区宣武门西大街甲127

号金隅大厦B座

邮编：100031

AI 硬件需求景气，关注 PCB 专用设备

2025 年 9 月 8 日

本期内容提要：

➤ PCB 需求恢复快速增长，AI 发展有望成为核心驱动因素。

印制电路板（PCB）是组装电子零件用的基板，2022-2023 年受消费电子疲软影响，全球 PCB 市场承压，行业产值 2023 年同比下滑 14.9%，随着消费电子复苏，2024 年同比增长 5.9%至 736 亿美元。今年以来，随着消费电子复苏、AI 发展带动高价值 PCB 产品需求，PCB 市场需求整体呈现景气加速趋势，Prismark 预计全年 PCB 行业全球产值增长 6.8%。伴随 AI 大模型和智能硬件应用的快速迭代，算力基础设施需求激增，驱动高性能服务器、GPU 和高阶 PCB 需求大幅增长，AI 相关领域有望成为未来 PCB 市场增长的核心驱动因素。据大族数控港股招股材料、Prismark，2024-2029 年 PCB 全球市场规模复合增速有望达到 5.6%，其中应用于服务器/存储领域的复合增速有望达到 10.0%，占比有望从 2024 年的 14.8%提升至 2029 年的 18.3%。

➤ PCB 厂商加速资本开支，重点投向 AI 相关产能。

在 PCB 市场需求景气提升下，各大 PCB 厂商加速产能扩张，尤其是在 AI 算力等中高端市场上的产能投资。1) 沪电股份 2024 年 10 月公告投资新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目，投资总额约 43 亿元人民币，计划年产约 29 万平方米人工智能芯片配套高端印制电路板。2) 胜宏科技 7 月公告向泰国孙公司增资 2.5 亿美元，用于泰国胜宏建设厂房、购买设备等，响应核心海外客户迫切要求公司扩大海外产能的需求。3) 东山精密 7 月公告投资建设高端印制电路板项目，以满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景对高端 PCB 的中长期需求，项目投资金额预计不超过 10 亿美元。4) 生益电子 8 月公告投资智能制造高多层算力电路板项目，旨在满足服务器、高多层网络通信及 AI 算力等中高端市场需求，计划投资总金额约 19 亿元人民币，项目年产印制电路板 70 万平方米。此前在 2024 年 12 月，公司公告投资约 14 亿元建设智能算力中心高多层高密互连电路板项目。

我们选择鹏鼎控股、东山精密、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、崇达技术这 8 家企业作为代表，其合计资本开支 2025H1 达到 124.68 亿元，同比增长 80.2%。

➤ PCB 专用设备受益，钻孔、曝光、检测价值量较高。

PCB 厂商积极扩产，带动专用设备需求。PCB 主要生产工序包括曝光、压合、钻孔、电镀、成型、检测等环节，据大族数控港股招股材料，2024 年全球 PCB 专用设备市场规模达到 70.85 亿美元，其中钻孔、曝光、检测、成型、电镀、压合设备分别为 14.7、12.0、10.6、6.2、5.1、4.2 亿美元，占比 20.7%、17.0%、15.0%、8.7%、7.2%、5.9%。预计 2029 年全球 PCB 专用设备市场规模将达到 107.65 亿美元，2024-2029 年复合增速达 8.7%。

➤ **建议关注：**

1) 大族数控：公司主要从事 PCB 专用设备的研发、生产和销售，产品涵盖 PCB 生产工序多种关键设备，包括热冷压合设备、机械钻孔设备、激光钻孔设备、激光直接成像设备、电测设备、光学检查设备等类型。公司客户涵盖 2024 年 Prismark 全球 PCB 企业百强排行榜 80% 的企业，灼识咨询统计公司全球市场占有率 6.5%，是全球 PCB 专用设备领域最大的供应商。

公司积极响应 AI PCB 发展带来的机遇，例如钻孔方面，公司除原有优势产经典双龙门设计机械钻孔机持续获得客户复购外，新开发的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机，可实现超短残桩及超高位置精度的背钻孔加工，也已获得行业终端客户的认证及多家高多层板龙头企业的大批量采购；公司研发的高功率及能量实时监测的 CO₂ 激光钻孔机可实现大孔径及跨层盲孔的高品质加工。在传统及任意层 HDI 市场，公司升级四光束 CO₂ 激光钻孔机、高解析度激光直接成像系统、定位精度±5μm 高精测试机等产品性能，以满足该 HDI 产品特征参数不断微缩的技术要求。

2025H1 公司实现营业收入 23.82 亿元，同比增长 52.26%；实现归母净利润 2.63 亿元，同比增长 83.82%。2025H1 公司毛利率达到 30.28%，同比提升 1.01pct。公司作为全球 PCB 专用设备领域最大的供应商，有望受益本轮 PCB 扩产需求。

2) 鼎泰高科：公司主要产品包括刀具产品（包含钻针、铣刀、PCB 特刀及数控刀具）、研磨抛光材料（包含磨刷、砂带等）、功能性膜材料、智能数控装备，主要面向的客户群为 PCB、数控精密机件制造企业等，2024 年应用在 PCB 领域相关的产品营业收入合计占公司总营业收入比重约 85%。作为全球 PCB 钻针龙头，公司客户包括胜宏科技、TTM 集团、深南电路、生益电子、方正科技、景旺电子、广合科技、崇达技术、健鼎科技等。受益于应用在 AI 领域的 PCB 板加工对钻针的需求增长，公司业绩实现高速增长，2025H1 实现营业收入 9.04 亿元，同比增长 26.9%，实现归母净利润 1.6 亿元，同比增长 79.8%。

公司积极扩产配合下游需求，业绩有望维持高速增长。据公司投资者关系活动记录表，PCB 微型钻针募投建设项目的年产能可为 4.8 亿支，月均产能为 4000 万支，计划今年内通过募投项目实施后的钻针月产能将达 2000 万支，在其他生产基地原有产能不继续提升的情况下，年内钻针月总产能可达 1 亿支以上。

3) 凯格精机：公司主要为电子装联产线提供锡膏印刷设备和点胶设备，一般用到 PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及到电子装联，下游主要涵盖消费电子、网络通信、汽车电子等行业。

2025H1 公司实现营业收入 4.54 亿元，同比增长 26.22%，实现归母净利润 0.67 亿元，同比增长 144.18%；其中锡膏印刷设备实现营业收入 2.92 亿元，同比增长 53.56%，主要原因系人工智能投资规模增加、AI 服务器需求的增长、消费电子需求回暖、新能源车渗透率的提升等带

来 PCBA 中 SMT 设备需求的增长。由于基板复杂度提高和高价值 PCB 组装需求的增长对锡膏印刷设备的稳定性、精度、智能化有更高的要求，公司上半年高毛利业务占比提升，综合毛利率为 41.86%，同比增加 9.58pct。我们认为 AI PCB 高景气下，公司设备需求有望持续较快增长，且利润率有望持续优化。

4) 芯基微装：公司是国内领先的直写光刻设备厂商，在 PCB 领域，公司设备主要应用于 PCB 制程中的线路层及阻焊层曝光环节，业务从单层板、多层板、柔性板等 PCB 中低阶市场向类载板、IC 载板等高阶市场纵向拓展。AI 服务器的高速迭代推动 PCB 朝高层数、高密度、高阻抗传输速度等方向发展，而直写光刻技术凭借无掩膜直写和实时形变补偿的技术特点，解决了 HDI 和高多层板曝光过程中对位精度与细线路的核心痛点，下游需求景气度上行，公司产能从今年 3 月开始处于超载状态，3 月单月发货量破百台设备，创下历史新高。

2025H1 公司实现营业收入 6.54 亿元，同比增长 45.59%，实现归母净利润 1.42 亿元，同比增长 41.05%。公司二期基地三季度有望进入投产期，为后续业绩增长和份额扩张奠定产能基础。

5) 东威科技：公司是全球领先的电镀设备制造商，产品主要面向 PCB 电镀领域、通用五金电镀领域、新能源电镀领域，垂直连续电镀设备在国内市场占有率在 50%以上。2025H1 公司实现营业收入 4.43 亿元，同比增长 13.07%；实现归母净利润 0.43 亿元，虽同比下降 23.66%，但 Q2 净利润同比增长 3.23%，环比 Q1 增长 49.93%。据公司半年报，上半年公司签单量保持了良好态势，尤其垂直连续电镀设备订单金额同比增长超过 100%。

PCB 电镀设备的性能高低和质量好坏能够在一定程度上决定 PCB 产品在集成性、导通性、信号传输等特性和功能上的优劣，AI 需求带动的 HDI、多层板等高端产品占比增加，对电镀设备的生产效率、品质等各方面要求都有所提升，价值量也相应增加，公司有望在下游 PCB 客户本轮扩产中受益。

➤ 风险因素：华为机器人进展不及预期、技术路线变化风险。



研究团队简介

王锐，吉林大学学士、北京师范大学硕士，曾就职于方正证券、光大证券、国泰君安，10 年行业研究经验，其中 7 年机械行业研究经验。2023 年加入信达证券研发中心，负责机械行业研究工作。

韩冰，浙江大学经济学学士、硕士，曾就职于东方证券、中泰证券，2023 年加入信达证券研发中心，主要覆盖通用设备、消费设备、检测、科学仪器等领域。

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入： 股价相对强于基准 15% 以上；	看好： 行业指数超越基准；
	增持： 股价相对强于基准 5%~15%；	中性： 行业指数与基准基本持平；
	持有： 股价相对基准波动在±5%之间；	看淡： 行业指数弱于基准。
	卖出： 股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。